

三菱電機 IR Day 2026 事業戦略 質疑応答要旨
(報道機関/機関投資家・アナリスト)

日時	: 2026年5月29日(金) 13:00~15:00
場所	: 三菱電機株式会社 本社(オンライン説明会)
当社出席者	: (第二部) ※BA: ビジネスエリア 執行役副社長 インダストリー・モビリティ BA オーナー 加賀 邦彦 常務執行役 ライフ BA オーナー 尋木 保行 常務執行役 インフラ BA オーナー 根来 秀人 常務執行役 半導体・デバイス事業本部長 竹見 政義 上席執行役員 FA システム事業本部長 都築 貴之 上席執行役員 防衛・宇宙システム事業本部長 洗井 昌彦

<第二部：事業戦略>

■報道機関

- Q. 既存の製造拠点を防衛向けに転用する取り組みも進めていることに加え、3つの工場棟を検討しているとの説明もあったが、今後の増産投資方針や背景について伺いたい。
- A. 現在、スピード感を持って取り組んでいるものが3棟ある。これに加えて、新しい事業や新たなビジネスも今後の計画に織り込んでおり、他の施設の活用も含めて5棟の計画を進めている。さらに、売上が急拡大していることから、物流エリアが不足しているため、物流エリアの拡充と工場内動線の効率化を進めている。これは単なる効率化にとどまらず、リードタイム短縮を通じて国際競争力の強化にもつながる。(洗井)
- Q. 3棟、5棟というのは新たな工場ではなく、鎌倉製作所などの既存の製作所において、棟単位で増設を検討しているという理解でよいか。
- A. ご理解のとおり。防衛・宇宙システム事業本部の鎌倉製作所、電子通信システム製作所に限らず、他の社内施設も含めて活用していく方針である。(洗井)
- Q. 株式会社東芝(以下、東芝)、ローム株式会社(以下、ローム)とのパワー半導体の3社協議について、毎週のように協議していると説明があったが、中国企業の台頭もあり、協議を急ぐ必要があるのではないか。三菱電機としてどのようなタイムラインで進めるべきと考えているか。
- A. もともとは東芝とロームの2社で検討されていたが、現在は当社含め3社で毎週のように協議をしている。期限を切っているわけではないが、中国企業や欧米の大手企業と対抗するには、最善を尽くし、全速で進めていきたい。(竹見)
- Q. 二相式液冷の説明があったが、三菱電機のIT Coolingの差別化要素は何か。
- A. 二相式液冷はこれから開発・製造・販売に力を入れていく。現時点での当社の強みは空冷システムであり、特にフリークーリングチラーや省エネ型チラーに強みを持つ。(尋木)
- Q. IT Coolingの国内外の生産体制の状況、今後の計画は。
- A. 生産体制の中心は、イタリア、インド、中国の工場である。日本では和歌山の冷熱システム製作所

で一部チラーを製造しているが、IT Cooling としての生産は限定的である。今後は海外の工場を中心に生産体制を強化していく。(尋木)

Q. 30年度の売上構成比では北米の比率はどの程度か。

A. 25年度時点では売上の大半は欧州、中国、アジア、インドが中心だが、30年度に向けては北米が2〜3割まで成長する見込み。(尋木)

Q. FAシステム事業のデジタルソリューションについて、工場の無人化・省人化は工場ごとに異なると思うが、どういう工場が進めやすいのか。また、現場で働く人員は今後どうなるのか。

A. すでにデータ収集の仕組みが整っている工場は、AI エージェントやフィジカル AI を導入しやすく、比較的早く進められると考えている。データ収集インフラが未整備の工場は、その整備から始める必要があるが、現在はネットワークやセキュリティ環境が充実しており、導入自体は比較的早くできるものと考えている。

大前提として、人手不足が進む中で、生産性や品質を維持するために省人化は重要だ。現場の人員は今後、現場作業から工場全体のオペレーションや AI 活用にシフトしていくと考えている。(都築)

Q. 社会システム事業の公共・交通事業における今後の見通しは。

A. 公共事業はコロナ禍による設備投資需要の停滞が回復し、堅調に推移している。交通事業も同様に回復してきた。今後、公共・交通事業では保守が鍵となる。国内では人口減少が進み、グローバルにおいても設備保守の重要性が増していく中、当社は Serendie でデータを活用して保守を最適化し、顧客に新たな提案をしていけるポテンシャルがある。また、交通事業はこれまで鉄道向けの車両用電機品などを中心に展開してきたが、今後はその範囲を広げ、駅を中心にさまざまなビジネスを展開していきたい。国内だけでなく欧州など海外にも可能性があると考えている。(根来)

Q. 社会システム事業の中ではデータセンター関連事業以外の利益の割合は減っていくのか。

A. ここ数年、公共・交通事業は構造改革、体質改善などにより損益が改善しており、データセンター関連事業だけが伸長し、それ以外が減少していくということはない。新規案件も獲得しながら、保守についてもデータを活用して効率化を図り、伸ばしていきたい。(根来)

Q. 東芝、ロームとの事業統合の主導権について、3社でどうバランスをとっていくのか。

A. まだ議論の最中であり、どこが主導権を持つかは決まっていない。3社それぞれの強みやアセットを組み合わせれば、大きく強い事業体ができると考えている。(竹見)

Q. ロームはまず東芝と半導体事業を統合し、その後にパワー半導体事業を切り出して三菱電機との3社で統合を進めるという考えを過去に示しているが、この2つの統合が同時に実現する可能性はあるのか。

A. 当社は東芝とロームの2社統合には直接関与していない。まず2社が統合ということではなく、2社から切り離されるパワー半導体事業と当社のパワー半導体事業の事業統合を目指しており、そのために最善最速の方法を考えている。(竹見)

Q. ライフビジネスエリア（以下、BA）の利益率向上に向けた体質強化を実行していくとのことだが、京都事業所など国内拠点の再編統合についての考えは。

- A. 京都事業所はかつてテレビの製造拠点だったが、テレビ事業の終息を経て現在はライフ BA の IoT 関連、特に空調のコントローラーなどを作る拠点になっており、デジタル家電を含むビジネスのデジタル化に寄与している。家電事業は国内市場では収益面でやや厳しい部分もあるが、当社ブランドを支えるうえで非常に重要な事業と考えており、収益性回復に向けた施策を進めていく。(尋木)

■機関投資家・アナリスト

- Q. エネルギーやモビリティ分野について、デジタル基盤「Serendie」をどのように活用し、ソリューションを拡大していくのか。競合他社が最終製品として強いコンポーネントやソリューションを持つ中、三菱電機の具体的な戦略と優位性は。

- A. 当社は、各地の製造拠点で多種多様なコンポーネントの開発・設計・製造を行っている。今後は実証拠点構想で示しているとおおり、Serendie を通じて各拠点のデータをつなぎ、掛け合わせて新たなソリューションを共創していく。これまで培った広く深いドメイン知識に基づく AI 活用により、お客様が気づいていない課題をともに解決することを目指す。(根来)

- Q. IT Cooling について、現在の競争環境は。また、30 年度の売上高 1,000 億円+に向けた成長のタイムラインと、液冷比率や二相式液冷の見通しは。

- A. AI データセンターの進展に伴う熱負荷増大により、冷却方式は従来の空冷から液冷への転換期にある。当社は現在展開中の単相式に加え、より冷却能力の高い二相式液冷システムの開発を加速させている。競争環境は日系・欧米メーカーが参入し激化しているが、当社は電源システムとの連携や、データセンター全体のファシリティを取りまとめる総合力において、欧州やアジアを中心に強みを有している。30 年度目標の 1,000 億円+のうち、半分弱を液冷関連が占めると見込んでいる。単相式と二相式の内訳については、市場動向を注視しつつ見極めていく。(尋木)

- Q. データセンター市場における DC 800V 電源システムのグローバルシェアの展望と差別化のポイントは。また CPO (Co-Packaged Optics) の立ち上がり時期をどのように予測しているか。

- A. 電源システムについては、AI データセンターへの GPU 導入に伴い、DC 800V 化へのシフトを認識している。当社は既存の UPS において、特に北米の 1,500kVA 以上の大容量帯でトップシェアを有している。長年にわたり北米で UPS を展開してきたことで、多くのお客様に採用いただいている。データセンターはミッションクリティカルな施設であり、これまで培ってきた技術力や高信頼性がお客様から高く評価され、シェアを拡大してきた。今後の DC 800V 化対応においても、NVIDIA と連携し、次世代システムの構築を進めている。高信頼性・高品質化が求められる中、既存の強力な顧客基盤を活かし対応していく。(根来)

CPO については、現時点では未成熟な技術である。北米 IT 大手などもプロトタイプを開発しているが、市場の立ち上がりは 28 年度から 29 年度頃、本格的な規模拡大は 30 年代に入ってからと予測している。現在、当社が強みとする EML チップはサーバー間の通信に使用されており、今後も市場拡大が継続する見込み。一方で CPO はサーバーラック内の通信が中心となるため、EML と CPO は使用領域を棲み分けながらともに伸長すると考えている。当社は EML で培ったインジウムリン (以下、InP) 技術を応用し、次世代 CPO 向けの要素技術開発を推進している。サーバー間およびラック内の双方において、技術トレンドをリードしていく方針。(竹見)

- Q. InP において、競合他社がウェハから作っているケースがあるが、懸念点はあるか。

- A. 現在の EML チップは、CW (Continuous Wave) レーザーに InP の変調器を集積した構成。次世

代の CPO においては、これらが個別に使われる可能性がある。変調器の部分は、薄膜ニオブ酸リチウム（以下、TFLN）などが使用される可能性もあるが、当社は InP の半導体の変調器が使用されると考えており、最終ユーザーのニーズも踏まえ、当社の開発計画も提示しながら要素開発を推進している。（竹見）

Q. 各セグメントの重点施策における、30 年度に向けた売上高成長率の想定に、M&A は織り込まれているのか。

A. インフラ部門は、成長に必要な投資として概算で織り込んでいる。（根来）

FA システム事業は、FA デジタルソリューションを中心に織り込んでいる。（都築）

ライフ部門は、アプライド空調領域のバリューチェーン拡大や、欧州における昇降機事業のマルチブランド保守体制強化に向けた投資を一定程度織り込んでいる。（尋木）

セミコンダクター・デバイス事業は織り込んでいない。（竹見）

Q. 防衛・宇宙システム事業における「サービス提供型ビジネス」の具体的内容と 30 年度の調整後営業利益率目標 12%への貢献度は。同ビジネスの利益率は従来の防衛システム案件と比較して高いのか。

A. サービス提供型ビジネスの具体的な案件としては、衛星コンステレーションや認知領域戦支援システムが挙げられる。衛星コンステレーションは、防衛省に対して衛星そのものを販売するのではなく、衛星で取得・解析した画像データを提供するビジネス。認知領域戦支援システムも昨今重要度が増している認知戦を具体的に数値化し、意思決定に必要なデータを提供するビジネスであり、提供するサービスの価値で勝負するビジネスとして挑戦している。これらのビジネスは従来のモノ売りとは異なる対価・利益率になると考えており、当社としてはより高い水準を目指している。一方で、現状は立上げ段階であり、30 年度の財務目標に対する影響は限定的。30 年度以降の事業成長と利益率向上に貢献することを期待している。（洗井）

Q. FA システム事業において、中国市場向けのローカルブランド機種種の展開状況と、同戦略が中国における事業全体にもたらす効果は。

A. 中国 FA 統括会社が開発・製造するサーボモータやインバータは、25～26 年度にかけて段階的に投入している。ローカルブランドは、従来の三菱電機ブランドが担うハイエンド領域と棲み分けており、ローレンジに投入している。一方で、従来の領域とのシナジーも期待できるため、事業全体にプラスの効果がある。（都築）

Q. インフラ部門におけるデータセンター向けソリューションの売上見通しの蓋然性について伺いたい。DC 800V 給電ソリューション受注の手応えや、SST（Solid State Transformer）の開発状況および競争力担保について教えてほしい。また、SST の開発はインフラ側で実施しているのか。加えて、IT Cooling システムを併せ持つことが、NVIDIA などからどのように評価されているか。

A. DC 800V 対応については、現在 NVIDIA と連携し、最適な回路方式の検討およびリファレンスデザインの策定を進めている。回路方式には、当社が想定している PWM（Pulse Width Modulation）コンバーター＋変圧器方式と SST 方式の 2 種類があり、それぞれに一長一短がある。現状は PWM コンバーター＋変圧器方式を主軸としているが、パワーデバイスのさらなる高耐圧化が進めば、SST 方式もメリットが出せる可能性があるかと認識している。今後、電圧が 1500V へと高まっていくトレンドも見据え、最適な方式を決定する。当社は鉄道分野などで培った高耐圧のパワーエレクトロニクス技術を有しており、これを電源回路の変遷に最大限活用する。なお、SST の開発はインフラ部

門が主体となりつつ、半導体・デバイス部門とも緊密に情報共有を行う BA 横断の体制で推進していく。また、IT Cooling については、電源システムと冷却システムをトータルで制御・最適化することで、PUE の向上に直結するこれまでにない省エネソリューションを提供できるため、しっかり取り組んでいきたい。(根来)

Q. 半導体・デバイス部門における、次世代 EML チップの先行開発の具体的な内容を伺いたい。また、CPO において、光源と変調器が分離された際、三菱電機の強みはどう発揮されるのか。併せて、光デバイスの 30 年度売上目標が、生産能力の増強に対して保守的に見える理由を教えてください。

A. 次世代 EML チップについては、1.6Tbps 通信向けの 200Gbps 製品に加え、更に次世代の 300Gbps および 400Gbps 製品の先行開発を推進しており、当社が業界をリードしていく。CPO については、現在市場では CW レーザーと TFLN 変調器を組み合わせる流れがあるが、TFLN はサイズが大きいという課題がある。当社は小型化が可能な InP 半導体変調器に強みを持っており、レーザーと変調器が分離された形態においても、双方を高性能なワンソリューションとして提供できる。

30 年度の光デバイス売上目標 800 億円に設定している理由は 2 点ある。1 点目は IT 業界特有の市況変動リスクを考慮している。2 点目はプロダクトミックスの変化。現在、データセンター内の短距離通信(約 100m)では安価な VCSEL が主流だが、800Gbps 以上の高速化に伴い、当社の得意とする EML チップへの置き換えが進んでいる。この領域の EML は、既存の長距離用 200Gbps 製品などと比較して単価が低くなる傾向にあるため、生産能力の増大(3 倍超)がそのまま売上高の倍率には反映されない計算となっている。しかし、800 億円以上はしっかり目指していきたい。(竹見)

Q. セミコンダクター・デバイス部門における光デバイスの営業利益率の見通しは。

A. 光デバイスの営業利益率は、部門全体の 25 年度実績(調整後営業利益率 16.1%)を上回り、パワーデバイスよりも高い水準にある。データセンター向け EML チップの売上高は 25 年度の 400 億円から 30 年度に 800 億円へと倍増させる計画で、利益率についても現在の高い水準を維持できる見込み。価格は値上げを前提とせず、お客様に当社の価値を認めていただける適切な価格設定を継続し、安定した営業利益率を確保する。(竹見)

Q. 宇宙システム事業の成長性と収益性改善の見通しは。新中期経営戦略の数値から防衛システム分を差し引くと、宇宙システム事業の売上高が伸びていないように見えるが、実態はどうか。

A. 防衛・宇宙システム事業の計画には、宇宙の安全保障利用が相当数含まれており、この領域は着実に伸長している。宇宙を民需と安全保障で峻別せず、デュアルユース領域として安心・安全な社会構築に貢献する。収益性は直近 2~3 年で改善しており、防衛・宇宙システム事業全体の標準的な利益水準に近づきつつある。今後も効率化と競争力強化を推進し、事業拡大を図っていく。(洗井)

Q. データセンターにおける電源システムと IT Cooling の連携につき、現状の手応えと、これらの仕組みを加速するための具体的な取組みは。TMEIC などとの連携における課題は。

A. UPS は北米が主要市場であり、MEPPI (Mitsubishi Electric Power Products, Inc.)、TMEIC と連携している。また UPS は、IT Cooling とともにソリューションを展開すべく取り組んでいるが、データセンターに関しては 26 年 4 月よりインフラ部門の下にプロジェクトグループを立ち上げ、事業本部、BA を横断したデータセンター全体の舵取りをはじめた。MEPPI の他、IT Cooling は欧州の MEHITS (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.) も含めて連携していく。また鴻海精密工業(以下、鴻海)との連携も活用しながらパフォーマンスを最大化すべく取り組んでいく。(根来)

- Q. シナジー効果はこれから出てくるのか。
- A. 既存のシステムは独立しているが、顧客基盤を活かして電源システムのお客様に IT Cooling を展開することは可能。今後はデータを吸い上げて上位の監視制御につなぎ、電源、IT Cooling を含め全体を一括して最適制御することができるようになる。DC800V では省エネがさらに重要な要素となるため、しっかりと対応していく。鴻海との協業に関してもデータセンターのフィールドを活用し、双方の知見を活かして最適なシステムをつくっていききたい。(根来)
- Q. セミコンダクター・デバイス事業の調整後営業利益率について、為替前提が保守的な中で、25年度実績 16.1%から 30年度に 20%へと改善する計画。光デバイスの利益率が変わらず、収益性確保が難しい SiC パワーデバイスが拡大する中、利益率をどのように向上させるのか。
- A. 利益率の高い光デバイスの規模拡大に加え、パワーデバイスの収益性が改善する。パワーデバイスについては、当社の強みである高信頼性・高耐電圧製品が評価され、市場シェアが高い HVDC 市場などの成長を取り込む。これらの領域は相対的に利益率が高く、規模拡大に伴う機種構成の改善が利益率を押し上げる。(竹見)
- Q. パワーデバイスの競争激化、SiC における収益性確保が難しい状況の中、高耐電圧、電力向け製品が増加すれば当社是对応できるのか。若しくは競争環境に変化が起きているのか。
- A. 26年度より SiC8 インチ泗水工場の償却が始まり利益が一旦下がるが、30年度に向けてピークが過ぎ、SiC のお客さまも徐々に増え規模が増加する。Si も利益率の高い向け先の規模が増加する。また SiC8 インチの新棟は高効率ラインのため、ランニングコストが下がりベースの基礎体力も上がり、利益率の上昇に繋がる。(竹見)
- Q. インフラ部門のデータセンター向けソリューションにおいて、給電方式が DC 800V へ移行した場合の事業の変化や事業規模のイメージを伺いたい。
- A. 現在のデータセンターは AC 入力による UPS システムが主流だが、今後は AI データセンターの普及に伴い、DC 800V への移行が進む見込み。給電方式の変化により、入力電源や電力変換装置のスペック、回路構成も刷新される。当社が提供する PWM コンバーター、レクチファイヤー(整流器)、DC/DC コンバーター、スーパーキャパシターといった主要コンポーネントは、当社の既存技術で十分対応可能な領域である。BESS(バッテリー、インバータ)が全体の電源保証を担い、スーパーキャパシターはサーバー側で発生する急峻なスパイク電圧を吸収する役割を果たす。PWM コンバーターとレクチファイヤーは、絶縁と電力変換を担う装置として機能する。
- 事業規模については、35年度の売上高目標として掲げる「2,700億円+」に、既存の AC システムと新たな DC システムの双方を含んでいる。800V 化のタイミングは GPU などのデバイス開発状況や NVIDIA の仕様に左右される流動的な面はあるが、35年度には増加するデータセンターのほぼ全てが AI 向けとなり、構成比も半分近くまで上昇するとの見込みもある。当面は既存の AC システムと DC システムが併用される期間が続くが、AI データセンターの増加に伴う電源システムの切り替えタイミングを確実に捉え、事業を拡大していく考え。(根来)
- Q. 半導体・デバイス部門の光デバイスについて伺いたい。次世代の CPO において、光源が CW レーザーへ移行し、変調器に TFLN などの新材料が検討される可能性がある。この場合、三菱電機のシェアや競争環境はどう変化すると考えているか。
- A. 通信速度の高速化に伴い、サーバー間通信用の EML チップ需要は今後も拡大し続けると考える。

一方で、サーバーラック内部の接続を担う CPO 向けの CW レーザーは、既存の EML 事業にアドオンされる新たな商機と捉えている。そのために InP ベースの技術開発を進める。(竹見)

Q. Nozomi Networks 社の買収を通じた OT セキュリティ事業の進捗とビジネスモデルを伺いたい。他社製機器も網羅する同社の強みと、デジタル基盤「Serendie」を掛け合わせたビジネスモデルの構築状況や、買収後の変化は。

A. 順調に進捗している。FA システム事業において多数の引き合いをいただいております、注目度の高さを実感している。工場の経営効率化や品質保証においてデータ活用が不可欠となる中、セキュリティ対策を切り離して考えることはできない。他社製機器を含む工場全体のセキュリティを担保できる同社の網羅性は、当社のソリューションにおいて重要な役割を果たす。また、お客様の合意の下で得られたデータを活用することで、現場に即した AI (フィジカル AI) や AI エージェントの開発を加速させることが可能となり、新たな付加価値の提供に繋がって行くと考えている。(都築)

Q. 26 年 1 月の買収完了から数カ月が経過したが、Serendie との一体化によるシナジー創出のタイムラインをどう期待すべきか。

A. シナジー創出については、将来的な期待ではなく「今すぐに取り組むべき事項」と捉えている。既に導入事例を順次積み上げており、各事業部門において Nozomi Networks 社の技術を積極的に活用するフェーズに移行している。(都築)

以上